

COBO OPEN INNOVATION - Call 4 Tech & Solution

Allegato 3 - Asset e competenze

Extended reality (Augment & Virtual Reality):

- Visori per lo sviluppo ed il testing di applicazioni basate su tecnologie di realtà estesa (*Meta Quest 2, HTC vive Pro, Hololens 2, altri device TBD*);
- Piattaforma messa a disposizione da TIM Extended Reality per progetti di Virtual / Augmented reality

Reti 5G:

- Piattaforme di connessione dispositivi a rete 5G per controllo remoto
- Rete 5G pubblica outdoor sugli spoke della CTE e indoor in 7 siti
- Strumenti per misure di campo elettromagnetico 5G
- Rete 5G standalone open-source funzionante nelle bande sub-6 GHz
- Connettività Low Power Area Network - NB-IoT

Additive Manufacturing:

- Piattaforme di stampa 2D large area e su substrati non convenzionali:
- Piattaforma di micro-nano fabbricazione
- Stampanti 3D polimeriche
- Stampanti 3D SLM per polveri metalliche

EDGE / cloud computing:

- Infrastruttura con risorse Edge/Cloud computing
- Quantum Key Distribution
- Piattaforma TIM Urban Genius per le Smart Cities ed i Servizi urbani innovativi
- Piattaforma di gestione SIM - TIM M2M Smart e NB IoT

Intelligenza artificiale:

- Applicazioni e piattaforme per gestione e deployment di soluzioni AI

Elettronica:

- Piattaforme di caratterizzazione elettrica e meccanica di substrati, materiali, tessuti e

sensori

- Piattaforma di microscopia elettronica
- Piattaforma di microscopia a forza atomica
- Piattaforma di spettroscopia ottica
- Strumentazione per la scansione 3D e la georeferenziazione del dato acquisito composta da:
 - a) laser scanner a lungo raggio Leica RTC360; b) laser scanner portatile Leica BLK2GO; c) piattaforma di mobile mapping di Leica Geosystems "Pegasus:Two Ultimate"; stazione Totale Leica TS13; unità Leica GS18 (base+rover) GNSS RTK.
- Radar a 77 GHz per localizzazione centimetrica di oggetti e persone

HPC (High Performance Computing):

- Quantum Machine
- Accesso al supercomputer Pre hexascale "LEONARDO"
 - 3456 nodi Booster module
 - 1536 nodi General Purpose module
 - 980 nodi equipaggiati con:
 - 2x16 cores IBM POWER9 AC922 at 3.1 GHz
 - 4 x NVIDIA Volta V100 GPUs, Nvlink 2.0, 16GB
 - 256 GB RAM
 - 554 nodi di equipaggiati con
 - 2 x 24 cores CPU Intel CascadeLake 8260
 - 384GB RAM

Suddivisi in:

- 340 standard nodes ("thin nodes") 480 GB SSD
- 180 data processing nodes ("fat nodes") 2TB SSD, 3TB Intel Optane
- 34 (visualization "viz") GPU nodes with 2x NVIDIA GPU V100